

中国集成电路封测行业发展趋势研究与未来投资 分析报告（2023-2030年）

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202307/641150.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

集成电路封测是集成电路产品制造的后道工序，指将通过测试的晶圆按产品型号及功能需求加工得到独立集成电路的过程，具体包含封装与测试两个主要环节。

集成电路封装是指将集成电路与引脚相连接以达到连接电信号的目的，并使用塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料制作外壳保护集成电路免受外部环境的损伤。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路提供了一个稳定可靠的工作环境，使集成电路能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性。

集成电路测试包括进入封装前的晶圆测试（CP）以及封装完成后的成品测试（FT），晶圆测试主要是在晶圆层面上检验每个晶粒的电性，成品测试主要检验切割后产品的电性和功能，目的在于将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的芯片筛选出来。

2021年受集成电路产能紧缺的影响，部分封测厂商提高了产品价格，加之下游市场需求旺盛，全球集成电路封测市场总体呈现较高的景气程度。数据显示，2020年全球集成电路封测行业市场规模约为591亿美元，同比增长4.8%。2021年全球集成电路封测行业市场规模估计可达到684亿美元，较2020年大幅增长15.74%。

预计随着5G通信、AI、大数据、自动驾驶、元宇宙、VR/AR等技术不断落地并逐渐成熟，全球集成电路产业规模将进一步提升，从而带动集成电路封测行业的发展。同时未来受集成电路产能紧缺的影响，部分封测厂商提高了产品价格，加之下游市场需求旺盛，全球集成电路封测市场总体有望保持较高的景气程度。有相关预测分析，到2025年全球集成电路封测行业市场规模可达824亿美元左右。

数据来源：观研天下整理

我国集成电路封装测试是整个中国半导体产业中发展最早的，在规模和技术能力方面与世界先进水平较为接近。近年来，我国集成电路封装测试业销售额逐年增长。2021年，消费类终端的强劲需求、新能源汽车渗透率的快速上升、数据中心的加速建设等因素均对集成电路封测行业形成强大的带动作用，同时供给需求的不匹配使得封测服务的价格水涨船高，叠加IC设计公司及晶圆制造企业的快速发展。数据显示，2021年我国大陆集成电路封测产业销售额达2,763.00亿元，较2020年增长10.10%。预计到2025年，我国大陆集成电路封装测试行业销售额将超过4,200亿元。

数据来源：观研天下整理

目前我国集成电路封测行业市场集中度较高，市场份额主要是被中国台湾及中国大陆企业所占据。中国大陆企业主要拥有长电科技、通富微电和华天科技三家综合性封测企业。三大综合性封测企业封装技术较为先进、可封装形式繁多，近年来通过海外并购快速积累先进封装技术，在BGA、Bumping、WLCSP、FC、TSV等先进封装领域布局完善，部分先进封装技

术已与海外厂商同步，但先进封装产品的占比与境外封测巨头仍存在一定差距。

目前我国集成电路封测市场上主要有长电科技、通富微电、华天科技、力成科技、京元电子、颀邦科技、甬矽电子、联咏科技等。

我国集成电路封测市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

长电科技

产品优势：公司目前提供的半导体微系统集成和封装测试服务涵盖了高、中、低各种半导体封测类型,涉及多种半导体产品终端市场应用领域。

运营服务优势：在韩国、新加坡、中国江阴、滁州、宿迁均设有分工明确、各具技术特色和竞争优势的全球运营中心,为客户提供从系统集成封装设计到技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试和芯片成品测试的全方位的芯片成品制造一站式服务。

技术优势：长电科技聚焦关键应用领域,在 5G 通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域拥有行业领先的半导体先进封装技术(如 SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP 及 XDFOI?系列等)以及混合信号/射频集成电路测试和资源优势,并实现规模量产,能够为市场和客户提供量身定制的技术解决方案。

专利优势：2022 年度,公司获得专利授权 114 件,新申请专利 278 件。截至本报告期末,公司拥有专利 3,019 件,其中发明专利 2,427 件(在美国获得的专利为 1,465 件)。

研发优势：公司在中国和韩国有两大研发中心,拥有“高密度集成电路封测国家工程实验室”、“博士后科研工作站”、“国家级企业技术中心”等研发平台;并拥有雄厚的工程研发实力和经验丰富的研发团队。

通富微电

客户优势：公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业,大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。

供应规模优势：公司是 AMD 最大的封装测试供应商,占其订单总数的 80%以上,未来随着大客户资源整合渐入佳境,产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。

研发优势：公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省集成电路先进封装测试重点实验室、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台,拥有一支专业的研发队伍,先后与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密的合作关系,并聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

技术优势：公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目,并取得了丰硕的技术创新成果:自建 2.5D/3D 产线全线通线,1+4 产品及 4 层/8 层堆叠产品研发稳步推进;基于 Chip Last 工艺的 Fan-out 技术,实现 5 层 RDL 超大尺寸封装(65×65mm);超大多芯片 FCBGA

MCM 技术,实现最高 13 颗芯片集成及 100×100mm 以上超大封装。

专利优势：截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计国内外专利申请达 1,383 件,其中发明专利占比约 70%。

生产布局优势：公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门建厂布局;通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权,在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地;2021 年,公司新增南通市北高新区生产基地。目前,公司在南通拥有 3 个生产基地,同时,在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局,产能方面已形成多点开花的局面,有利于公司就近更好地服务客户,争取更多地方资源。

华天科技

技术优势：公司通过技术攻关,逐步掌握了国际先进的高密度集成电路封装核心技术,现有封装技术水平及科技研发实力已处于国内同行业领先地位。目前公司已掌握了 SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D 等集成电路先进封装技术。

盈利优势：多年来,公司在不断扩大产业规模,快速提高技术水平的同时,通过持续不断的技术和管理创新,使公司保持了健康持续快速的发展,公司的盈利能力在国内同行业中处于领先水平。

营销网络优势：经过十多年的不懈努力,公司已与国内外客户建立了稳定良好的长期合作关系,并建立了一套行之有效、覆盖较为全面的营销网络,保证了公司能够第一时间接收到市场最新动态,并对其做出快速、准确的反应。

品牌优势：公司荣获“中国半导体市场值得信赖品牌”、“中国半导体市场最具影响力企业”和“中国十大半导体封装测试企业”等荣誉和称号。

力成科技

经验优势：公司前身为美国超微半导体和飞索半导体,拥有 20 年以上的量产经验。

团队优势：公司建立了销售和客户服务团队。

客户优势：公司为世界一流的 IDM 及 IC 设计客户群提供每月超过 210M 的出货量。

京元电子

市场布局优势：公司在北美、日本、欧洲、中国大陆、新加坡设有业务据点。

市场地位优势：公司测试营收世界排名第二,为全球最大的专业测试厂。

品牌优势：身为世界最大专业测试公司,京元电子集团获得在手机、无线通讯、显示屏驱动器(LCDD)、绘图卡、利基型 DRAM、NOR

Flash、消费性电子产品、微机电系统(MEMS) 等产品市场里的领导厂商给予认证下单。

顾邦科技

封装测试优势：顾邦科技是国内唯一有能力完成 LCD 之驱动之 IC 全程封装测试之公司。

客户优势：公司拥有国内外驱动 IC 大厂客户群。

技术优势：公司拥有「覆晶封装技术」与「晶片尺寸封装(CSP ; Chip Scale Package)」此二类先进技术之专业封装厂商,其产品线的规划可完全满足未来封装的主流需求。

研发优势：公司除持续投入可观研发经费金凸块产品制程、无电电镀制程、COF封装技术及无铅产品等领域外，为加速研发技术能力之提升，同时与国内工研院及学校等研究机构单位及国外各半导体大厂进行技术交流与合作。

甬矽电子

客户优势：公司与恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、富瀚微(300613)、联发科(2454.TW)、北京君正(300223)、鑫创科技(3259.TW)、全志科技(300458)、汇顶科技(603160)、韦尔股份(603501)、唯捷创芯、深圳飞骧、翱捷科技、锐石创芯、昂瑞微、星辰科技等行业内知名芯片企业建立了合作关系。

技术优势：公司在高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)、系统级封装产品、4G/5G射频功放封装技术、高密度大尺寸框架封装产品、MEMS封装产品、IC测试等领域均拥有核心技术。

专利优势：自2017年11月成立至2022年6月30日止,公司总计取得了88项发明专利授权、96项实用新型专利授权、外观专利2项。

联咏科技

品牌优势：2022年5月，入选福布斯2022全球企业2000强榜单，排名第1908位。2023年1月，位列《2022年胡润中国500强》排名第313位。

市场布局优势：公司在东京、北京、上海、深圳、成都、武汉、西安、苏州、合肥、香港等地设有服务基地。

资料来源：观研天下整理（WW）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国集成电路封测行业发展概述

第一节 集成电路封测行业发展情况概述

- 一、集成电路封测行业相关定义
- 二、集成电路封测特点分析
- 三、集成电路封测行业基本情况介绍
- 四、集成电路封测行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、集成电路封测行业需求主体分析

第二节 中国集成电路封测行业生命周期分析

- 一、集成电路封测行业生命周期理论概述
- 二、集成电路封测行业所属的生命周期分析

第三节 集成电路封测行业经济指标分析

- 一、集成电路封测行业的赢利性分析
- 二、集成电路封测行业的经济周期分析
- 三、集成电路封测行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球集成电路封测行业市场发展现状分析

第一节 全球集成电路封测行业发展历程回顾

第二节 全球集成电路封测行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲集成电路封测行业地区市场分析

- 一、亚洲集成电路封测行业市场现状分析
- 二、亚洲集成电路封测行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲集成电路封测行业市场前景分析

第四节 北美集成电路封测行业地区市场分析

- 一、北美集成电路封测行业市场现状分析
- 二、北美集成电路封测行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美集成电路封测行业市场前景分析

第五节 欧洲集成电路封测行业地区市场分析

- 一、欧洲集成电路封测行业市场现状分析
- 二、欧洲集成电路封测行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲集成电路封测行业市场前景分析

第六节 2023-2030年世界集成电路封测行业分布走势预测

第七节 2023-2030年全球集成电路封测行业市场规模预测

第三章 中国集成电路封测行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对集成电路封测行业的影响分析

第三节中国集成电路封测行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对集成电路封测行业的影响分析

第五节中国集成电路封测行业产业社会环境分析

第四章 中国集成电路封测行业运行情况

第一节中国集成电路封测行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国集成电路封测行业市场规模分析

一、影响中国集成电路封测行业市场规模的因素

二、中国集成电路封测行业市场规模

三、中国集成电路封测行业市场规模解析

第三节中国集成电路封测行业供应情况分析

一、中国集成电路封测行业供应规模

二、中国集成电路封测行业供应特点

第四节中国集成电路封测行业需求情况分析

一、中国集成电路封测行业需求规模

二、中国集成电路封测行业需求特点

第五节中国集成电路封测行业供需平衡分析

第五章 中国集成电路封测行业产业链和细分市场分析

第一节中国集成电路封测行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、集成电路封测行业产业链图解

第二节中国集成电路封测行业产业链环节分析

- 一、上游产业发展现状
- 二、上游产业对集成电路封测行业的影响分析
- 三、下游产业发展现状
- 四、下游产业对集成电路封测行业的影响分析

第三节我国集成电路封测行业细分市场分析

- 一、细分市场一
- 二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国集成电路封测行业市场竞争分析

第一节中国集成电路封测行业竞争现状分析

- 一、中国集成电路封测行业竞争格局分析
- 二、中国集成电路封测行业主要品牌分析

第二节中国集成电路封测行业集中度分析

- 一、中国集成电路封测行业市场集中度影响因素分析
- 二、中国集成电路封测行业市场集中度分析

第三节中国集成电路封测行业竞争特征分析

- 一、企业区域分布特征
- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国集成电路封测行业模型分析

第一节中国集成电路封测行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国集成电路封测行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会

五、行业威胁

六、中国集成电路封测行业SWOT分析结论

第三节中国集成电路封测行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国集成电路封测行业需求特点与动态分析

第一节中国集成电路封测行业市场动态情况

第二节中国集成电路封测行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节集成电路封测行业成本结构分析

第四节集成电路封测行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国集成电路封测行业价格现状分析

第六节中国集成电路封测行业平均价格走势预测

一、中国集成电路封测行业平均价格趋势分析

二、中国集成电路封测行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国集成电路封测行业所属行业运行数据监测

第一节中国集成电路封测行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国集成电路封测行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国集成电路封测行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国集成电路封测行业区域市场现状分析

第一节中国集成电路封测行业区域市场规模分析

一、影响集成电路封测行业区域市场分布的因素

二、中国集成电路封测行业区域市场分布

第二节中国华东地区集成电路封测行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区集成电路封测行业市场分析

(1) 华东地区集成电路封测行业市场规模

(2) 华南地区集成电路封测行业市场现状

(3) 华东地区集成电路封测行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区集成电路封测行业市场分析

(1) 华中地区集成电路封测行业市场规模

(2) 华中地区集成电路封测行业市场现状

(3) 华中地区集成电路封测行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区集成电路封测行业市场分析

(1) 华南地区集成电路封测行业市场规模

(2) 华南地区集成电路封测行业市场现状

(3) 华南地区集成电路封测行业市场规模预测

第五节华北地区集成电路封测行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 华北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 华北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 华北地区集成电路封测行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 东北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 东北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 东北地区集成电路封测行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 西南地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 西南地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 西南地区集成电路封测行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 西北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 西北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 西北地区集成电路封测行业市场规模预测

第十一章 集成电路封测行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2023-2030年中国集成电路封测行业发展前景分析与预测

第一节中国集成电路封测行业未来发展前景分析

一、集成电路封测行业国内投资环境分析

二、中国集成电路封测行业市场机会分析

三、中国集成电路封测行业投资增速预测

第二节中国集成电路封测行业未来发展趋势预测

第三节中国集成电路封测行业规模发展预测

一、中国集成电路封测行业市场规模预测

二、中国集成电路封测行业市场规模增速预测

三、中国集成电路封测行业产值规模预测

四、中国集成电路封测行业产值增速预测

五、中国集成电路封测行业供需情况预测

第四节中国集成电路封测行业盈利走势预测

第十三章 2023-2030年中国集成电路封测行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国集成电路封测行业进入壁垒分析

一、集成电路封测行业资金壁垒分析

二、集成电路封测行业技术壁垒分析

三、集成电路封测行业人才壁垒分析

四、集成电路封测行业品牌壁垒分析

五、集成电路封测行业其他壁垒分析

第二节集成电路封测行业风险分析

一、集成电路封测行业宏观环境风险

二、集成电路封测行业技术风险

三、集成电路封测行业竞争风险

四、集成电路封测行业其他风险

第三节中国集成电路封测行业存在的问题

第四节中国集成电路封测行业解决问题的策略分析

第十四章 2023-2030年中国集成电路封测行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国集成电路封测行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国集成电路封测行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 集成电路封测行业营销策略分析

一、集成电路封测行业产品策略

二、集成电路封测行业定价策略

三、集成电路封测行业渠道策略

四、集成电路封测行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202307/641150.html>